



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**

CONSULTA PÚBLICA Nº 37 - SEI, 29 DE NOVEMBRO DE 2022

A Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, de acordo com os artigos 8º e 9º da Portaria Interministerial SEPEC-ME/MCTIC nº 32, de 15 de julho de 2019, torna pública a proposta de **alteração** do Processo Produtivo Básico – PPB de MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE ("TOUCH SCREEN") - TABLET-PC.

O texto completo está disponível no sítio da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, no endereço:

<https://www.gov.br/produktividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/competitividade-industrial/processo-produtivo-basico-ppb/consultas-publicas-de-ppb-1/consultas-publicas-de-ppb-2022>

As manifestações deverão ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, a todos os seguintes e-mails: cgel.ppb@economia.gov.br, cgct.ppb@mcti.gov.br e cgpri.ppb@sufrema.gov.br.

GLENDIA BEZERRA LUSTOSA

Secretária de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços

ANEXO

PROPOSTA Nº 044/22 – ALTERAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO PARA MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE (“TOUCH SCREEN”) – TABLET-PC, ESTABELECIDO PELAS PORTARIA INTERMINISTERIAL SEPEC/ME/MCTIC Nº 5, E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL SEPEC/ME/MCTIC Nº7, AMBAS DE 26 DE JUNHO DE 2019.

1) Alteração da redação das etapas IX e X dos Anexos das Portarias Interministeriais nº 5 e nº 7, de 26 de junho de 2019, conforme abaixo:

Etapa IX

DE:

Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de acesso à rede de comunicação sem fio.

PARA:

Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de acesso à rede de comunicação sem fio, **quando não integradas a placa principal.**

Etapa X

DE:

Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de acesso à rede celular.

PARA:

Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de acesso à rede celular, **quando não integradas a placa principal.**

2) Inclusão do § 3º do art. 1º nas Portarias Interministeriais nº 5 e nº 7, de 26 de junho de 2019:

Art. 1º (...)

(...)

§ 3º Quando a placa que implemente a função de processamento central incorporar a função de acesso à rede de comunicação sem fio, descrita na etapa IX do Anexo, a pontuação mínima de 40 (quarenta pontos), estabelecida no § 1º deste artigo, passará a ser de 34 (trinta e quatro) pontos. (NR)